

证券代码：300782

证券简称：卓胜微

江苏卓胜微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他（电话会议）
参与单位名称	参会单位：（以下排名不分先后） 诺安基金、鹏华基金、泓德基金、博时基金、华泰柏瑞基金、交银施罗德基金、创金合信基金、中金公司、国信证券、华泰证券、广发证券、国投证券、兴业证券、光大证券、天风证券、东北证券、山西证券、东海证券、南京证券、国海证券、华福证券、爱建证券、长城证券、上海证券、东亚前海证券、国元证券、瑞银证券、汇丰前海证券、摩根士丹利证券（中国）、第一上海证券、华安财保资管、长城财富资管、中国东方资产、睿郡资产、宁泉资产、理成资产、循理资产、七叶树资产、伯兄资产、橡果资产、道仁资产、红年资产、鸿竹资产、浙江睿光、哲云私募、博笃投资、尚颀投资、朗程投资、涌乐投资、湘禾投资、理臻投资、金蟾蜍投资、中才中环投资、鑫融长弘投资、南京交控私募、银河投资、国海创新资本、荣州聚享智研、稻盛企管、招银国际、环球电信资本、嘉恒投资等
时间	2026年8月26日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：许志翰先生

	董事会秘书：刘丽琼女士
投资者关系活动 主要内容介绍	一、简要介绍公司2026年半年度整体情况 近两年，AI持续驱动产业链供需与价格变化，引发全球多种芯片需求和价格持续增长，对下游智能手机行业市场结构与景气度产生了一定的持续性负面影响，同时也引发上游多环节供给紧张，公司所在的射频芯片行业景气度亦有所传导和关联，行业竞争持续激烈，经营情况阶段性承压较大。 2026年半年度，公司实现营业收入18.1亿元，同比增长6.2%，归属于上市公司股东的净利润-3.71亿元，同比下降151.53%。盈利下滑的主要原因系公司在Fab-Lite转型期间因持续的产能建设投入、折旧带动成本费用的增加及供应转化影响、产品结构变化，叠加由AI引发的产业链供给侧需求挤兑和原材料价格上涨及竞争仍然激烈等综合因素影响。 二、在问答环节，主要回复如下： 1、请问公司 L-PAMiD 系列产品的市场进展及收入贡献情况如何？ A：尊敬的投资者，您好！公司 L-PAMiD 系列产品正处于加速市场渗透阶段，并已取得关键商业化成果。公司已推出覆盖多种主流架构的解决方案，可灵活满足不同品牌客户的前端设计需求，并已在多家品牌客户实现导入和大规模出货，验证了产品的高可靠性与交付能力。报告期内，该系列产品出货增速持续强劲，预计未来几个季度仍可保持较高增速，并在国内市场已形成良好的竞争势头。感谢您的关注！ 2、请问公司在 WiFi 领域的产品布局及进展如何？ A：尊敬的投资者，您好！在无线连接领域，公司已成功卡位技术前沿。WiFi 7模组产品已实现规模化量产，凭借性能优势在客户端保持快速增长，是公司重要的增量产品之一。WiFi 8射频模组产品已率先完成部分客户导入并开始小批量出货，公司是市场上率先实现WiFi 8射频产品出货的厂商之一，先发优势明显。在应用结构上，公司WiFi产品目前以手机端市场为主，后续将逐步向路由器等网通类产品拓展。感谢您的关注！ 3、请问公司向光互联领域战略延伸的考量、自我定位及目前进展？ A：尊敬的投资者，您好！光互联是公司基于长期战略研判作出的重大战略决策，与公司现有射频业务具备良好的协同效应。技术层面，光互联与射频同属高频高速电子领域，公司自建的芯卓工艺平台（SOI、锗硅等特色工艺）可实现有效迁移与复用；运营层面，公司Fab-Lite模式在光互联领域同样适用且价值突出。

	相较于标准工艺代工厂，公司工艺更关注定制化、更关注对性能的追求，选择好的合作伙伴来共同推动好的产品。目前，公司光芯片与电芯片业务并行推进。工艺层面，基于射频前端产品的工艺技术积累，公司在锗硅工艺上已具备丰富的量产能力，为推动该工艺在电芯片业务复用夯实基础；硅光工艺目前正进入最后的定型阶段。 在光通信等新兴应用领域，公司12英寸晶圆生产线所构建的SOI、SiGe等特色工艺，在底层技术逻辑与平台架构上与射频前端所需工艺具备高度的共通性与协同基础。上述工艺均根植于同一硅基异质集成体系，共享制造集成等多种核心能力，可在统一平台上实现多种特色器件的兼容与集成，展现出对新兴应用场景良好的适用性与延展性。相较当前行业普遍量产的8英寸产线，12英寸产线在晶圆尺寸上具备显著的规模优势，单片可承载的有效芯片面积更大，有利于摊薄单位制造成本、提升产出效率；同时更大尺寸的平台能够承接更先进的制造装备与更优的工艺均匀性控制，在良率、一致性与器件性能等方面形成系统性优势，使公司在面向未来技术演进的特色工艺布局上建立起更具前瞻性的先进性与规模壁垒。感谢您的关注！ 4、请问公司整体产能利用率情况如何？基于对消费电子行业需求情况的判断，对后续季度的产能利用率趋势该如何预期？ A：尊敬的投资者，您好！受消费电子行业周期波动影响，公司一季度产能利用率相对较低，二季度已有所回升，预计三、四季度将保持稳定。全年产能利用率水平仍受下游需求节奏影响，存在一定不确定性。产能布局方面，公司12英寸产线现有SOI工艺产能约9,000片/月，现有洁净室资源可支撑产能进一步扩充；同时公司将持续根据新产品、新工艺的推进节奏，逐步补充关键设备，并灵活调配资源以匹配市场需求。感谢您的关注！ 5、请问公司在BCD工艺的商业化将采用怎么样的模式，从中期维度来看，公司对该工艺有什么样的考量？ A：尊敬的投资者，您好！以BCD工艺为代表的功率电源方向，是公司特色工艺平台能力的重要延伸，也是公司服务算力中心等新兴领域的重要布局。公司在该方向坚持差异化发展策略，依托自身特色工艺与创新设计能力，聚焦高价值应用场景。公司持续保持高强度的研发投入，研发人员占比保持较高水平，人员结构等研发资源在射频主业与光芯片、电芯片、高性能电源等新方向的布局并行推进、相互协同并不冲突，为公司未来增长曲线奠定坚实基础。感谢您的关注！
--	---

	6、请问公司毛利率的变动趋势及影响因素？ A：尊敬的投资者，您好！公司毛利率阶段性的波动主要受两方面因素影响：一是产能利用率阶段性偏低，对成本结构产生阶段性影响；二是新产品在早期阶段成本相对较高。对此，公司已采取多项措施加以改善：一方面，随着高端模组等新产品出货量的持续增加，公司将逐步优化工艺、提升良率、改善成本结构；另一方面，公司近期就供应链供需情况提出了合理的价格调整诉求。感谢您的关注！ 7、请介绍公司存货减值的计提情况及当前库存健康度。 A：尊敬的投资者，您好！公司一贯严格遵守企业会计准则及信息披露的相关规定，执行较为审慎的存货减值政策。报告期内，公司存货减值与冲回并存，其中冲回主要来源于部分前期计提的产品实现销售。当前，公司产成品、半成品及原材料的库存结构总体健康合理，公司将持续加强存货管理，推动呆滞库存的消化与变现，保障资产质量。感谢您的关注！ 8、公司自上市以来在工艺上做了很多的储备，也打磨深耕多年。请问公司在工艺上有哪些进展和壁垒突破？ A：尊敬的投资者，您好！公司以6英寸滤波器晶圆生产线为基础，针对特种材料化合物工艺进行平台建设，围绕压电晶体、GaAs等化合物工艺，以及基于SAW的覆膜封装工艺，已具备较为完整的产品生产制造实力。同时，以12英寸硅基技术平台生产线为基础，致力于特色异质材料及特种工艺的能力拓展，工艺布局覆盖SOI、IPD、BCD、SiGe等特色异质材料及特种工艺。并以前瞻性视野重点投资并构建了封装工艺技术平台，先进集成工艺已实现技术落地和闭环，为未来光电共封等高集成度产品提供核心支撑。展望未来，随着资源平台效能持续释放、客户协同不断深化，公司有望依托“设计+工艺”双轮驱动的核心优势，在巩固成熟业务的同时，加速向AI端侧、汽车电子等高增长市场拓展，同时前瞻性地储备了面向光通信、卫星通信、低空经济等新兴领域的基础技术底蕴，以稳健的经营韧性迎接产业机遇。感谢您的关注！
附件清单（如有）	无
日期	2026年8月26日